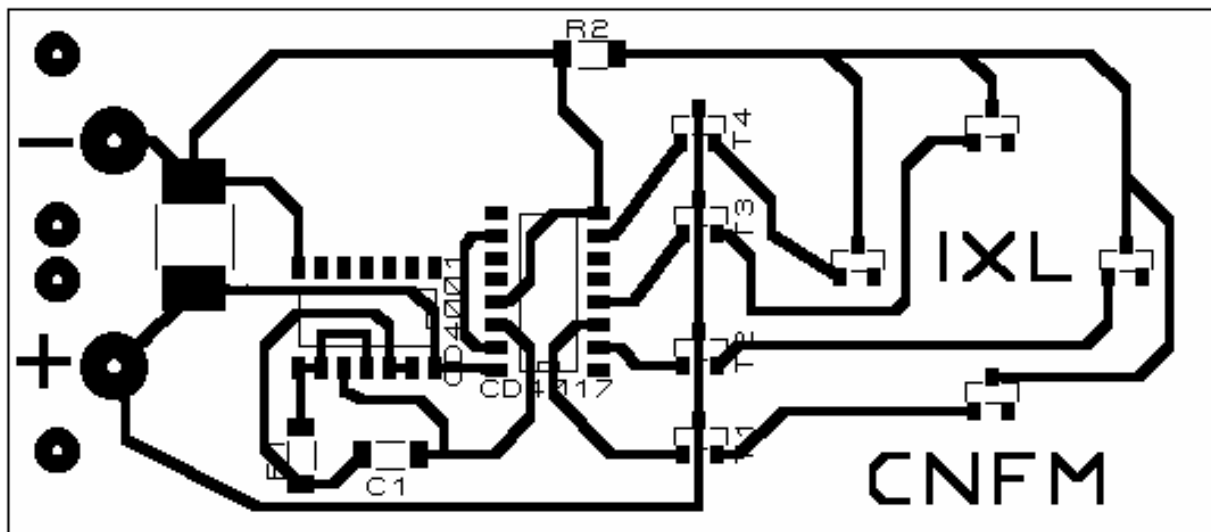


## Microassemblage

### Objectifs :

- conception et réalisation circuit sur substrat verre époxy (chenillard) avec : CAO, typon, PCB, montage CMS, assemblage, test
- circuit hybride couches épaisses sur substrat céramique alumine (circuit redresseur) avec : fabrication écran, sérigraphie, cuisson, report puces, câblage, caractérisation
- notions d'analyse des microassemblages



*Circuit chenillard : exemple d'implantation.*

### Matériels :

- PC, Logiciels CAO (Ares)
- Insoleuse, Machine à graver PCB
- Sérigraphieuse
- Fours de cuisson, Tapis de refusion
- Robot de report de composants montés en surface
- Microcâbleuses
- MEB, Laminographe

### Formations :

- DESS MICROELECTRONIQUE Bordeaux – 35 heures
- DEA ÉLECTRONIQUE Bordeaux – 35 heures
- ENSEIRB – 7 heures
- DESS MICROELECTRONIQUE Toulouse – 35 heures

### Formateurs :

- Hélène DEBEDA-HICKEL, MCF UFR de Physique Bordeaux 1
- Corinne DEJOURS, MCF UFR de Physique Bordeaux 1
- Dominique NAVARRO, IR ENSEIRB

Contact : [dejous@ixl.u-bordeaux.fr](mailto:dejous@ixl.u-bordeaux.fr)